

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	广州广芯封装基板有限公司半导体封装基板产品制造项目安全预评价报告		
委托单位	广州广芯封装基板有限公司		
项目类别	安全预评价报告		

**项目简介:**

广州广芯封装基板有限公司成立于2021年8月12日；营业期限：长期；企业类型：属于有限责任公司（法人独资）；住所：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之643（仅限办公）；法定代表人：杨之诚；注册资本：贰亿元（人民币）；统一社会信用代码：91440101MA9Y1DC01P；经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

广州广芯封装基板有限公司拟在广州市黄埔区九龙镇集成电路创新园内，人才九路以南、创新大道以西、创育四路以东（中新广州知识城）建设半导体封装基板产品制造项目。建设内容为：1号厂房（研发楼）、2号厂房（G2）、3号厂房（G3）、5号厂房（G5）、4号厂房（停车楼）、6号宿舍楼、7号宿舍楼、8号宿舍楼、9号仓库、10号动力站、11号废水处理站等，产能为年产20000万颗/年FC BGA基板、150万片/年RF基板和150万片/年FC CSP基板。

项目组长	谢雄英
项目组成人员	邱儒杰、黄倩雯
报告审核人	游海
过程控制负责人	韩效栋
技术负责人	刘海军
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境情况

**评价结论:**

广州广芯封装基板有限公司半导体封装基板产品制造项目主要危险、有害因素为火灾、中毒和窒息、机械伤害，应重视机械设备及危险化学品的储存、使用的对策措施。该项目在设计、施工和生产过程中若能全面落实本报告提出的相应安全对策措施及建议，做到建设项目安全设施的“三同时”，确保各项安全措施有效的条件下，评价组认为广州广芯封装基板有限公司半导体封装基板产品制造项目符合国家安全生产法律法规及相关安全标准、规范的基本要求，其安全程度是可以接受的，其风险程度是可控的，符合建设项目对安全条件的要求。

**现场照片:**

